

# 中关村光电产业协会

## 中关村光电产业协会关于《高密度小间距植球技术规范》、《大深宽比后硅通孔技术要求》、《基于玻璃浆料键合的 MEMS 晶圆级封装技术规范》等十三项团体标准公开征求意见的通知

各有关单位、专家：

由中关村光电产业协会组织制定的《高密度小间距植球技术规范》、《大深宽比后硅通孔技术要求》、《基于玻璃浆料键合的 MEMS 晶圆级封装技术规范》等十三项团体标准已完成征求意见稿。

根据《中关村光电产业协会团体标准管理办法》，为保证标准的科学性、严谨性和适用性，现公开征求意见，欢迎社会各界对标准内容提出修改意见和建议。请各有关单位组织审阅，并于 2025 年 6 月 15 日之前将修改意见反馈至联系人。逾期未回复，视为认可征求意见稿中相关内容。

联系人：周岚

联系电话：010-82028905

邮箱：zgcgdcyhx@163.com

